

## 普冉半导体（上海）股份有限公司

### 关于增加 2026 年度银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加2026年度银行综合授信额度的议案》，本议案尚需经股东会审议批准。现将相关情况具体内容公告如下：

#### 一、已审议通过的综合授信情况概述

1、公司于 2026 年 3 月 20 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，批准公司（含子公司及控股子公司）向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 15 亿元（含本数）。

2、公司于 2026 年 8 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司调整 2026 年度综合授信额度及授信期限的议案》，将综合授信额度由 15 亿元调整至不超过人民币 18 亿元（含本数）。

#### 二、本次增加银行综合授信额度的情况

##### （一）本次增加银行综合授信额度的原因

为满足公司经营规模扩大、业务拓展及中长期战略发展的需要，同时为保证公司流动性安全、降低融资成本、提高资金使用效率，公司（含子公司及控股子公司）拟进一步增加银行综合授信额度。

##### （二）本次银行综合授信额度的方案

1、授信额度：公司拟增加向银行等金融机构申请综合授信额度 20 亿（含本数），本次增加后，公司向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 38 亿元（含本数），在额度内可循环滚动使用。

2、授信品种：包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、银行

承兑汇票、商业汇票贴现、保函、信用证、贸易融资、票据池业务、债券包销额度，债券投资额度、风险缓释工具等。

3、 授信银行：具体授信银行及各银行额度以公司最终与银行签署的授信协议为准。

4、 授权期限：自公司股东会审议通过之日起至公司下一年度授信额度经有权机构审议批准之日止。公司可在该授权有效期内，向各金融机构完成本次综合授信的申报、对接及签约落地等相关工作。

5、 授信期限：在授权有效期内成功获批的授信额度，按金融机构审批结果执行，具体授信期限、使用规则以各银行最终审批文件及双方签署的正式合同为准。本次获批的各类授信额度，在各自核定的授信有效期内可循环使用，公司将根据日常经营实际资金需求，在审批过的综合授信总额度内自主确定具体融资金额、业务品类及办理节奏，单笔授信业务的实际存续期限以业务合同约定为准。

6、 授权事项：为高效推进本次授信及融资相关工作，提请股东会授权公司董事长在上述授信总额度及董事会授权有效期内，根据公司实际经营需求，全权负责办理本次综合授信、融资业务的申报、洽谈、落地等相关事宜，并代表公司签署授信协议、借款合同及其他相关配套法律文件，具体事项由财务部负责组织实施。

7、 其他事项：本次公司申请增加 2026 年度综合授信额度相关事项，不涉及对外提供担保、子公司相互提供担保等情形。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日